

IPC J-STD-001G 焊接的电气和电子组件要求

航天和军事应用电子部件补充标准

目录

下列标题列于本补充标准

- 0.1 范围
- 0.1.1 目的
- 0.1.2 优先顺序
- 0.1.3 已有的和先前批准的设计
- 0.1.4 使用
- 0.1.5 无铅锡基焊料
- 0.1.6 红斑现象（氧化亚铜腐蚀）
- 0.1.7 材料和过程可追溯性

下列引用编号对应 J-STD-001G 条款在本补充标准中有修改或增加。

1.1	范围
1.2	目的
1.7	优先顺序
1.7.1	冲突
1.10	员工熟练程度
1.11	验收要求
1.13.2.2	高频应用
1.13.2.3	高压应用
3.1	材料
3.2	焊料
3.2.1	焊料—无铅
3.3	助焊剂
3.8.1	元器件和密封损伤
4.2.3	照明
4.5	元器件表面处理去除
4.5.1	除金
4.6	热保护
4.9	一般零件安装要求
4.9.2	引线变形限度
4.15.3	烘干 / 排气
4.18.1	暴露的表面
4.18.2	焊接连接缺陷

4.18.3	部分可见或隐藏的焊接连接
5.1.2	股线损伤
5.3.6	接线柱安装 - 焊接
5.4.1.6	绝缘皮套管（焊接到穿孔、钩形和锡杯端子的导线）
5.5	端子的焊接
5.6.3	跳线的固定
6.1	通孔收尾—通用要求
6.1.1	引线成形
6.1.2	收尾要求
6.2.2	通孔元器件引线焊接
6.3.1	非支撑孔中引线收尾要求
7	元器件的表面贴装
7.1.2	表面贴装器件引线成形
7.1.3	非故意弯曲
7.5.6	城堡形端子
7.5.8	圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线
7.5.14	表面贴装面阵列封装
7.5.15	底部端子元器件（BTC）
7.5.16	具有底部散热面端子的元器件（D-Pak）
7.5.17	平头柱连接
8.3	焊后清洁度
8.3.1	外来物（FOD）
8.3.2	助焊剂残留物和其它离子或有机污染物
9.1.1	起泡 / 分层
9.1.2	露织物 / 切纤维
9.1.9	烧焦
9.1.11	白斑
10	涂覆、灌封、加固和粘接
10.3	敷形涂覆—应用
10.3.10	敷形涂覆层的返工或修补
10.6[新]	粘接（粘合剂）
12.1.2	目视检验
12.3	统计过程控制
13.2	维修